

ECTC(2024/5/28-31@米国・デンバー)出展のご案内

三菱マテリアル株式会社は、100%子会社の米国三菱マテリアル社と共同で5月28日（火）～31日（金）に米国・デンバーにて開催される半導体関連学会「ECTC(2024 IEEE 74th Electronic Components and Technology Conference)  (英語)」に併設の展示会に出展致します。

ECTCは半導体関連を中心としたパッケージング、電子部品、マイクロエレクトロニクスシステム等幅広い分野の技術者が一堂に集い、最先端の技術、動向、情報を発信する世界最大級の国際学会です。

本学会に併設される展示会において、私たちの目指す姿である「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」のもと、世界的に高シェアを誇るバンプ形成用低 α 線 Pb フリーはんだめっき液や AuSn 合金ペーストに加え、先端パッケージング向けに現在開発を進めているナノポーラス Cu めっき、大型角型 Si 基板材等の半導体関連製品をご紹介させていただく予定です。

本学会にお越しの際は、是非当社ブースにお立ち寄りください。

プログラム

<https://ectc.net/program/74-ECTCFinal-Web.pdf>

出展期間

2024年5月29日（水）～30日（木）

5月29日 9:00am-12:30pm, 2:00 -6:30pm

5月30日 9:00am-12:30pm, 2:00 -4:00pm

会場

Gaylord Rockies Resort & Convention Center

6700 North Gaylord Rockies Boulevard Aurora, Colorado, USA, 80019

当社ブース番号：506



2024 ECTC EXHIBITION

Exhibit Hall Hours

Wednesday, May 29

9:00 a.m. - 12:30 p.m. / 2:00 p.m. - 6:30 p.m.

Thursday, May 30

9:00 a.m. - 12:30 p.m. / 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Aurora 1 Ballroom

